

## LPVBG25A

### 产品特性:

尺寸  
 芯片尺寸: 11mil x 25mil  
 (275±25μm x 625±25μm)  
 芯片厚度: 4.6mil(115±15μm)  
 焊盘尺寸: 2.6mil(67±10μm)

焊盘金属



产品介绍  
 Product Introduction



产品介绍  
 Product Introduction

## 最大额定值

DC 正向电流	150mA
正向峰值电流 (1/10占空比@1kHz)	240mA
LED结温	115°C
反向电压	5V
使用温度范围	-40 ~ 85°C
贮存温度范围	0 ~ 40°C

### 说明:

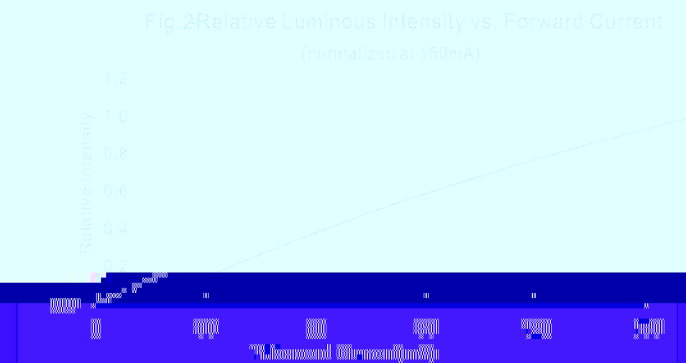
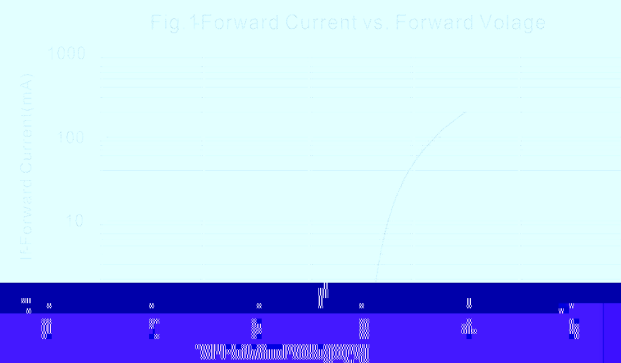
1. 最大额定值为晶光电封装条件下测试得到, 不同封装形式得到的值会有所不同, 建议在不超过最大额定值的条件下使用, 超过最大额定值使用可能会引起LED芯片损坏.
2. 本产品非设计与反向电流 (压) 下使用, 不建议在任何反向电流 (压) 下使用.

LPVBG25A

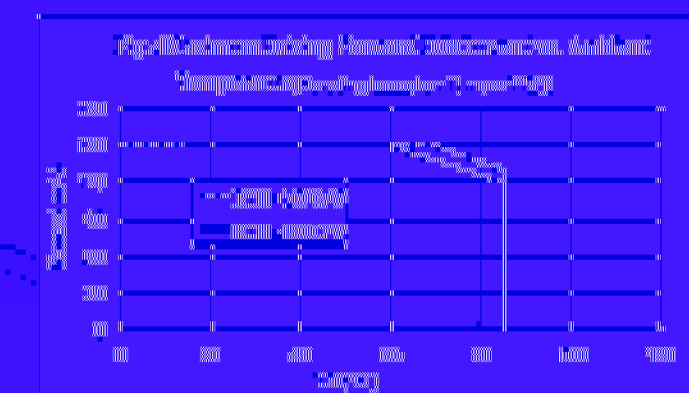
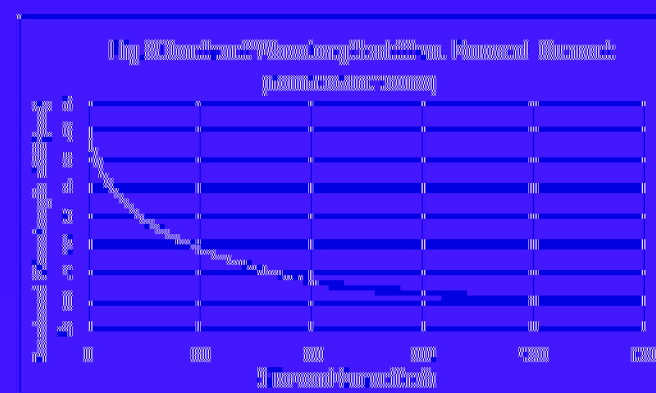
LPVBG25A

## 光电参数

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
开启电压	V <sub>th</sub>	IF=10μA	2.0	---	2.8	V
工作电压	V <sub>D</sub>	IF=150mA	3.0	---	3.6	V
反向漏电流	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> =5V	---	---	1	μA
主波长	λ <sub>d</sub>	IF=150mA	445	---	475	nm
半波宽度		IF=150mA	---	---	30	nm



封装形式	器件型号	器件型号	器件型号	器件型号	器件型号	器件型号
25mil x 11mil	LPVBG25A	LPVBG25A	LPVBG25A	LPVBG25A	LPVBG25A	LPVBG25A
25mil x 11mil	LPVBG25A	LPVBG25A	LPVBG25A	LPVBG25A	LPVBG25A	LPVBG25A
25mil x 11mil	LPVBG25A	LPVBG25A	LPVBG25A	LPVBG25A	LPVBG25A	LPVBG25A
25mil x 11mil	LPVBG25A	LPVBG25A	LPVBG25A	LPVBG25A	LPVBG25A	LPVBG25A



说明:  
 1. 最大额定值为晶光电封装条件下测试得到, 不同封装形式得到的值会有所不同, 建议在不超过最大额定值的条件下使用, 超过最大额定值使用可能会引起LED芯片损坏.  
 2. 本产品非设计与反向电流 (压) 下使用, 不建议在任何反向电流 (压) 下使用.

